



即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛穆銳農)

MCA

電話: +1-650-968-8900 分機 125

電郵: dmoreno@mcapr.com

在 EUV 微影技術和多電子束光罩刻寫技術成為 2017 年主題之際，中芯國際 (SMIC) 加盟 EBEAM INITIATIVE

聖荷西，加州，美國，二零一七年二月二十八日—The eBeam Initiative，一個致力於推廣和倡導電子束技術在半導體製造全新應用的團體，今天宣佈，中芯國際積體電路製造（上海）有限公司 (SMIC) 一世界頂尖晶圓代工廠商之一，正式加盟 eBeam Initiative。這個半導體技術的權威機構將其獨特視角和領導力，帶入已有超過 45 家涵蓋半導體光罩和微影的整個供應鏈成員組成的 eBeam Initiative 大家庭中。相關的新聞，the eBeam Initiative 今天同時宣佈其 2017 年將教育與宣導的重點聚焦於電子束技術的需求與發展，用以支持 EUV 微影和多電子束光罩刻寫技術。The eBeam Initiative 將邀請業界專家對上述提及的項目在 eBeam Initiative 全年的系列活動中進行深入的探討；就在今天，SPIE Advanced Lithography Conference 會議期間，假聖荷西會議中心舉辦的會員和媒體午餐會中開啟今年系列活動的序幕。

“中芯國際在兩年前的 eBeam Initiative 年度光罩製造商調查開始就是積極的參與者，”中芯國際光罩廠資深總監郭貴琦(Eric Guo)表示，“作為 eBeam Initiative 新成員，我們期望繼續支援 eBeam Initiative 類似年度光罩製造商調查計畫，不但對我們自身有所幫助，更惠及整體光罩界。”

去年, The eBeam Initiative 所做的第五屆年度會員意見調查中，涵蓋半導體微影和光罩整體供應鏈的 73 位業界專家參加了調查。調查結果顯示，對 EUV 微影的負面印象是歷年調查以來最低的；而對其樂觀的印象，則保持穩定；相較其他微影技術 (NGL)，對 EUV 的信心有所增加。同時，對多電子束光罩刻寫的認知，則格外引人注目；期待光罩會在 2018 年底大量使用多電子束光罩刻寫機於製造端。這種期望反應出對多電子束技術的認可持續增加—不管在半導體製程中應用哪種微影技術，光罩複雜程度的增加及對電子刻寫精度的需求都形成了對多電子束技術需求的增長。The eBeam Initiative 會員調查結果清晰地顯示圍繞在 EUV 微影和多電子束刻寫相

關課題與電子束新發展的興趣與方向，the eBeam Initiative 將增加其在教育推廣上的努力，聚焦在這兩項重要的技術領域上。

“對 the eBeam Initiative 來說，這實在是令人激動的時刻，” D2S 執行長藤村 (Aki Fujimura) 先生表示，D2S 是 eBeam Initiative 的主辦管理公司。“我們不但見證將 EUV 微影用於量產上的持續進展和信心的增長，還有光學微影技術持續突破其可能想到的物理極限—通過多重微影技術 (multi-patterning techniques)，逆向微影技術 (ILT-Inverse Lithography Technique)，高階複雜圖形光罩，以及多電子束光罩刻寫。所有這些進展都和電子束技術的創新緊密相關，也因此，類似於 the eBeam Initiative 的努力，對業界通力合作的需求也被凸顯出來。對此，我們非常高興的歡迎中芯國際 (SMIC) 成為我們的新會員。對於我們正在進行的工作：提高光罩界和半導體界對電子束技術重要性的認知，它帶來了其獨特的觀點和看法。”

一年一度的 eBeam Initiative 會員和媒體午餐會將於今天舉行。會上將有業界專家專題講座。題目包括：電子束技術在快速 EPE (Edge Placement Error-邊界定位誤差) 測量中的進展；多電子束光罩刻寫光罩模型，和 ILT 的再次崛起。講座內容將會在二月二十八日後發表於 eBeam Initiative 網站上 www.ebeam.org。

“此次會議 (SPIE Advanced Lithography Conference) 後的一年中，the eBeam Initiative 還將在其它業界論壇繼續其在 EUV 微影技術和多電子束光罩刻寫領域中電子束新進展的教育與宣導努力。” 藤村又表示，“隨後的幾個月，我們會在三月舉行的中國國際半導體技術年會 (CSTIC) 和四月舉行的日本光罩年會 (PMJ) 上再次強調這些議題的重要性；在四月的日本光罩年會 (PMJ) 上，會有 GPU 加速在光罩技術上應用的特別章節介紹。”

關於 The eBeam Initiative (電子束倡議團體)

The eBeam Initiative 是一個致力於推廣和倡導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。The eBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多集成電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。

會員公司，涵蓋整個半導體生態系統，包括: aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KLA-Tencor; Maglen; Mentor Graphics Corporation; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photonics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai)

**SMIC JOINS THE EBEAM INITIATIVE AS EUV LITHOGRAPHY AND MULTI-BEAM MASK WRITING
BECOME KEY THEMES FOR 2017.....PAGE 3 OF 3**

Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; TOOL Corporation;
Toppan Printing; Toshiba; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS.
The eBeam Initiative 歡迎所有電子工業的公司和協會加盟。細節請查看 www.ebeam.org.

###